

厂家批发 高导热灌封胶 低粘度渗透性强高导热灌封胶 双组份环氧灌封胶

产品名称	厂家批发 高导热灌封胶 低粘度渗透性强高导热灌封胶 双组份环氧灌封胶
公司名称	石家庄银琥珀新材料科技有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	品牌:利鼎 产地:河北石家庄 颜色:可调
公司地址	河北石家庄循环化工园区工业大街99号
联系电话	13191854244

产品详情

环氧树脂高导热灌封胶

LD-106灌封胶是双组份低黏度加温固化灌封材料，解决灌封胶渗透差、排泡难、固化后浇注体开裂的问题。

一、产品特点:

除具备一般环氧树脂灌封材料的特点外,特别具有:1、黏度低，易流动，自排泡性能好；2、固化物柔韧性好、机械强度高；3、线性膨胀系数和体积收缩率小；4、导热和耐热性能优异。二、产品用途:

LD-106环氧树脂灌封胶适用于大体积、高导热、高耐温及耐冷冻的电子产品的灌封，如干式变压器、干式互感器、高压包、电机线圈等。

三、性能指标

项目	106A	106B
黏度(40 cps)	5000-10000	40-50
颜色	黑色	淡黄
项目	测试方法	数值
温度循环	(-45 +155)	10次无开裂
潮湿	15 时湿度51%	IR无增加
功率老化	全动态96H	无击穿
阻燃性	UL-94	V-1
体积电阻率(/cm)	ASTM D257	1.0 × 10 ¹⁴
表面电阻率()		
耐电压(KV/mm)	ASTM D14	20
导热系数(w/m.k)	ASTM D5470	0.8-1.3
硬度	Shore D	85 ± 5

注：粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整

四.使用方法：1、先将A料搅拌5分钟，然后预热至60 备用。2、将欲灌封的电子元器件在100 加热，驱除潮气。3、按照A：B=4：1的比例（重量比）将A、B料混合均匀，在60 下抽真空10-20min，然后对电子元器件进行灌封，灌封不易过满，灌封完毕后的器件抽真空10-20min，然后补胶。（真空度0.1MPa）4、补胶完毕，按75 下2小时+100 下1-2小时+120 下1-2小时(或根据要求调整固化工艺)进行加温固化，固化完全的器件要随炉冷却到自然温度后再取出。

五、注意事项

- 1、按重量配比取量混合后充分搅拌均匀，以避免固化不完全。
- 2、搅拌均匀后请及时灌胶，操作过程中用多少配多少，避免浪费,在操作时间内使用完已混合的胶液。
- 3、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。
- 4、有极少数人长时接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮擦去，并使用清洁剂清洗干净。
- 5、如果胶液溅入眼睛，请立刻用大量清水冲洗，并请就医处理。

六、包装、储存

- 1、本品包装规格为30KG/套（A胶料24KG，B固化剂6KG）。
- 2、本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期6个月，过期经试验合格，可继续使用；